

第92回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 21 年 12 月 4 日(金) 10:30～16:30

場 所：自動車会館（東京 市ヶ谷）

	時 間	題 目	講 演 者
平成 21 年 12 月 4 日 (金)	司 会 福本信次 (大阪大学)		
	10:30 ~ 11:15	『半導体集積回路の性能向上のための 計算機シミュレーション』	茨城大学 ○篠嶋 妥, 大貫 仁
	11:15 ~ 12:00	『半導体パッケージにおける基板と ヒートシンクの高放熱接合』	(株)三菱電機 ○藤野純司
	12:00 ~ 13:00	昼 食 休 憩	
	13:00 ~ 13:10	委 員 会 議 事	
	司 会 芹沢弘二 ((株)日立製作所)		
	13:10 ~ 13:55	『最近のはんだ・フラックス材料や 評価技術などに関する規格化の状況 (JIS, IEC 等)』	(社)日本溶接協会 はんだ・微細接合 部会 千住金属工業(株) R&D センター ○鶴田加一
	13:55 ~ 14:40	『はんだ接合部におけるニューラルネットワーク 自動視覚検査システムの入力情報改善手法』	大阪大学 ○松嶋道也, 河合直浩 藤江裕之, 副田輝, 藤本公三
	14:40 ~ 15:00	休 憩	
	司 会 作山誠樹 ((株)富士通研究所)		
	15:00 ~ 15:45	『システムデザイン・インテグレーション手法と 次世代半導体デバイスにおけるケーススタディ』	大阪大学 ○岩田剛治, 多屋淳志 村田秀則, 佐藤了平 岡本和也, 工藤啓治
	15:45 ~ 16:30	『LSI パッケージの組み立て プロセスを考慮した反りの予測』	富士通アドバンステクノロジ(株) ○伊東伸孝 富士通マイクロエレクトロニクス(株) 夏秋昌典 (株)富士通研究所 水谷大輔, 倉科守

プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。